

证券代码：301041

证券简称：金百泽

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年5月13日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 武守坤先生 独立董事 赵亮先生 独立董事 方先丽女士 独立董事 秦曦先生 董事会秘书 陈鹏飞先生 保荐代表人 丁冬梅女士
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 1. 看到行业不景气的情况下，公司表现良好，请介绍下去年整体业绩及公司主营业务IDM的前景么？ 答：2023年度，公司实现了营业收入63,569.81万元，较上年同期减少2.45%；实现归属于上市公司股东净利润3,963.77万元，较上年同期上升17.01%。其中，报

告期内公司聚焦集成设计与制造服务IDM、注重产品中试与加速的科创服务及电子电路数字赋能云工厂平台，以设计和制造为手段,提供生产型、科创型和数字科技服务，其中公司科创服务及数字化平台服务业务取得从0-1阶段性的成果。去年整体来看，国内外经济形势复杂多变，国际贸易环境紧张，市场情况不确定性增加。公司的主营业务IDM面临机遇和挑战并存的局面，一方面，工业4.0和数字化转型的持续推进加速了对IDM服务的需求，智能制造技术的发展，如AI、物联网IoT和机器学习技术的应用，可能会增强IDM市场的活力。另一方面下，公司IDM业务下PCB市场消费需求较为低迷，电子电路行业总体增长乏力，欧美国家电子制造供应链出现回流和向东南亚转移态势，但PCB原材料覆铜板、半固化片、铜箔供应紧张状况得到缓解，大部分原辅物料价格有所回落；电子元器件供应趋于平稳，供应紧张状态得到有效缓解，价格有所回落。感谢关注！

2. 请问董事长，公司造物数科如何助力产业数字化转型和高质量发展？

答:公司深耕电子电路产业，致力于打造电子电路产业的工业互联网平台。依托金百泽集团二十余年服务“专、精、特、新”客户的经验和产业资源积累，基于“产业互联+云工厂”创新模式，携手华为云共同打造电子电路产业互联网平台。旗下子公司造物数科打造的“应龙造物”品牌，以硬件研发服务为路径，加速“数字平面”和“实体平面”的有机融合，链接研发工具链、工业仿真、行业资源库等一系列面向电子电路产业建立的数字与软件生态，与相关方新型网络化研发与制造新范式，深耕产业，协同服务客户，推进各方乃至行业实现协作共赢。造物数链接产业生态，打造电子电路

云工厂新范式。为客户提供从设计到研发、试产到量产的全流程一站式服务。为企业数字化转型提供软硬一体化解决方案，赋能硬件创新和产业数字化升级。感谢关注！

3. 公司在低空经济领域布局已经很久了，而且在航空航天领域也有所进展，并且和中航国际供应链公司战略合作，请具体介绍下公司在这低空经济和航天航空这两个两大领域的布局和产品运用，和未来的发展前景

答:尊敬的投资者，您好！公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，集成集成电路设计与制造IDM、科创服务、数字化平台服务等业务板块。产品和服务应用广泛，有应用于航空航天领域、无人机等领域。公司会将持续关注低空经济及相关行业的发展机遇，积极拓展相关市场。感谢您的关注！

4. 看到报告中提到了公司在研发投入上的增加，这是否意味着公司正在积极布局新产品或新技术？如果是的话，能否透露一些关于这些研发项目的信息？

答:尊敬的投资者，您好！公司2023年的研发投入约4,671.54万，且最近三年呈逐年上升趋势。随着公司进入新的发展时期，公司将坚定集成设计与制造主业IDM，做大做强集成电路设计、PCB中小批量和EMS一站式服务，增加研发投入，推动新技术、数字化平台建设、新产品的开发，以提高企业竞争力和市场份额，密切关注新兴技术的发展趋势，如人工智能、新能源、5G、低空经济等，及时应用于产品和服务中。

5. 请问公司2024年一季度业绩情况？

答:尊敬的投资者，您好！2024年一季度，公司实现营业收入15,265.59万元，同比上涨2.64%，归属于上市公司股东的净利润582.90万元，同比上涨46.41%，业绩变

动原因主要是公司收入同比增长，毛利率提高影响。公司将持续聚焦主业集成设计与制造IDM，巩固技术优势，深挖重点行业，做好内部的提质增效，不断提升公司经营和管理水平，以良好的业绩回报投资者。感谢您的关注！

6. 贵公司2023年度经营现金流如何？

答:尊敬的投资者，您好！2023年度，经营活动产生的现金流量净额10,460.75万元，同比去年同期增长280.93%，经营现金流改善原因主要是，一方面，是公司成立了应收账款管理小组，加强应收账款催收力度，并通过事前审核、事中监控、事后款项清收，做好应收账款风险管控工作，客户回款情况较好；另外一方面，公司加快技术创新、提升工艺能力，促进产品结构升级，减少了相关成本采购等支出。感谢您的关注！

7. 请问贵公司在国际市场的表现如何？面对国际贸易环境的紧张，公司有哪些策略来维持或增加外销比例？

答:尊敬的投资者，您好！2023年度，公司境外主营业务收入1.54亿元，占主营业务总收入24.65%，较上年同期增长7.60%，毛利率同比增长2.78%。在国际贸易及地缘政治因素影响下，公司将发挥香港公司优势，夯实国际基础，凭借银行长期服务、进出口海关、国际贸易等优势，以及香港公司长期品牌积累，将为公司在国际市场推广提供有力支持。同时，为有效化解国际政治因素带来的鸿沟，提高供应链的灵活性和韧性，公司也将考虑规划布局东南亚产能。最后，公司将同步推动科技创新，布局北美市场，通过数字化平台集成设计与制造IDM、科技创新服务落地北美市场形成真正国际BG的所有格局。具体情况请以公司对外披露的相关信息为准。请

感谢您的关注！

8. 公司在2023年有研发投入如何吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司2023年的研发投入约4,671.54万，且最近三年呈逐年上升趋势。随着公司进入新的发展时期，公司将坚定集成设计与制造主业IDM，做大做强电子电路设计、PCB中小批量和EMS一站式服务，增加研发投入，推动新技术、数字化平台建设、新产品的开发，以提高企业竞争力和市场份额，密切关注新兴技术的发展趋势，如人工智能、新能源、5G、低空经济等，及时应用于产品和服务中。

9. 请问您如何看待公司目前的资产负债状况？是否有计划通过资本市场融资来优化资本结构或支持未来的扩张计划？

答:尊敬的投资者，您好！截止2023年12月31日，公司资产负债率26.20%，整体财务状况稳健，后续将持续优化资产负债结构。资本市场融资计划将根据实际融资需求、战略布局、发展规划等条件综合研判，后续若实施相关项目，将严格根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

10. 感觉公司和传统的PCB企业不一样，请问公司的主要业务是什么，是否有重大变化？

答:尊敬的投资者，您好！公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，聚焦集成设计与制造服务IDM、注重产品中试与加速的科创服务及电子电路数字赋能云工厂平台，以设计和制造为手段,提供生产型、科创型和数字科技服务。报告期内，公司的主要业务未发生重大变化，公司的主要业务可分为集成与设计制造IDM下的电子设计服务、印制电路板PCB、电子制造服务EMS以及科创服务、数字平台平台服务等。感谢您的

关注！

11. 公司可以服务人工智能方面吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，集成电子电路设计与制造IDM、科创服务、数字化平台服务等业务板块。公司的产品和技术有应用于人工智能相关领域。未来，公司将持续发挥已有优势，把握人工智能发展带来的市场新机遇，投入技术和产品研发，提升技术能力和服务能力，深入服务人工智能的各个领域。感谢您的关注！

12. 请问公司会做股权激励吗？

答：公司已根据市场情况和公司财务情况规划，有序在二级市场进行回购；关于股权激励或员工持股计划是实现核心人员与公司长期成长深度结合的重要途径，能够有效地把股东利益、公司利益和核心团队成员利益结合在一起，充分调动员工积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司战略和考核期内经营目标的实现。公司将根据公司战略和人才发展计划，利用回购股份适时推出员工持股或股权激励等激励方案。后续公司将严格按照信息披露管理办法等有关规定及时进行披露。感谢关注！

13. 请问公司在2023年度的利润分配预案是如何考虑的，未来的分红政策会有哪些变化吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者回报，上市以来每年度连续实施现金分红，比例均超过当年实现的可供分配利润的15%以上。未来分红策略，将严格根据公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》及相关法律法规，同时结合公司实际情况制定、履行。感谢您的关注！

	<p>14. 公司产品可以用于无人机么？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司的集成设计与制造服务IDM一直以来都有应用于无人机等领域；公司将持续关注低空经济的发展机遇，积极拓展相关市场。感谢您的关注！</p> <p>15. 请问公司对未来分红有何规划？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者回报，努力做好各项经营管理工作，不断改善经营质量及提升盈利能力。上市以来，每年度公司连续实施现金分红，并按照相关法律法规和《公司章程》等规定，制定《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》、《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月13日